

DWG. NO. SD-53309-**-27

E

D

C

B

A

8

7

6

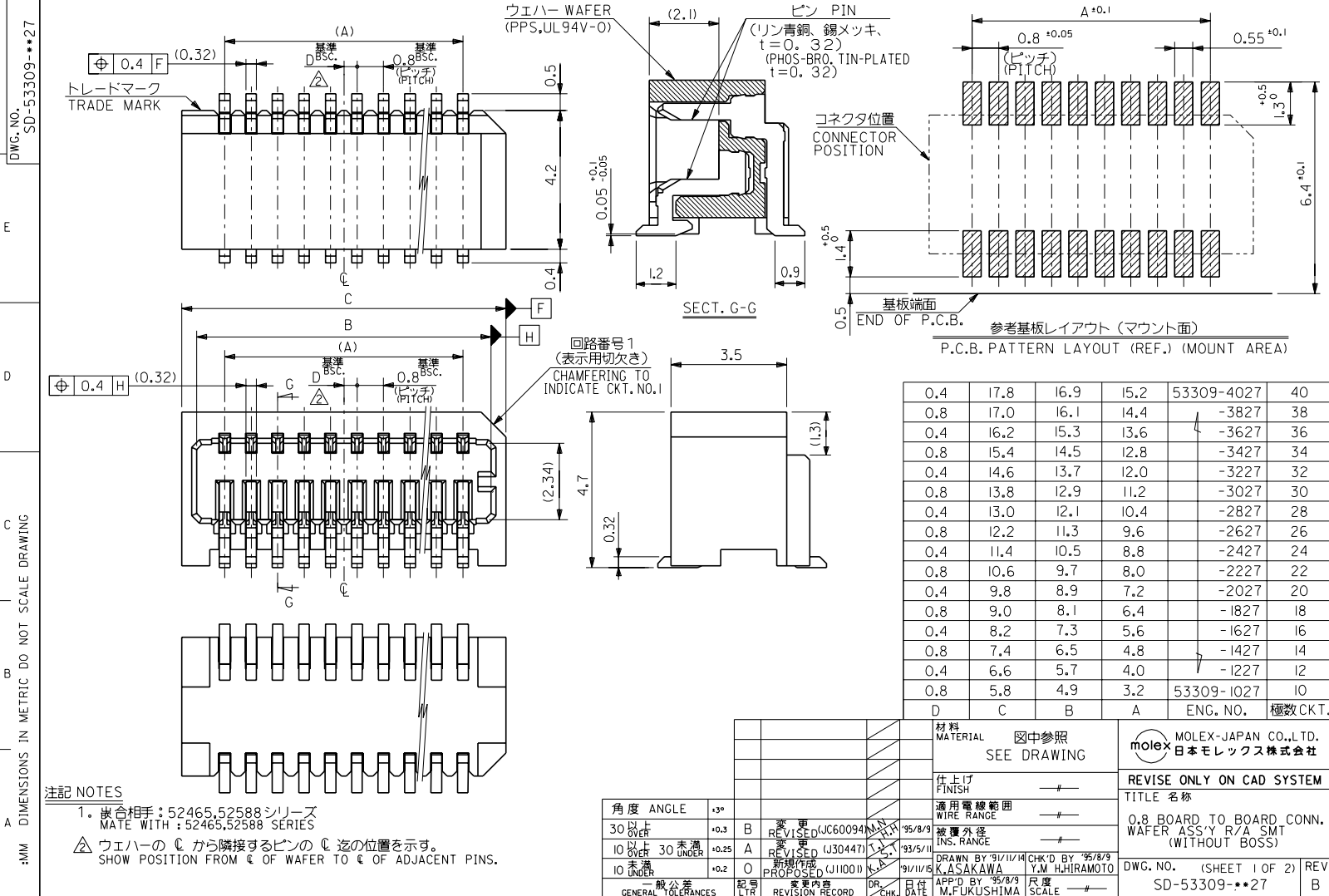
5

4

3

2

1



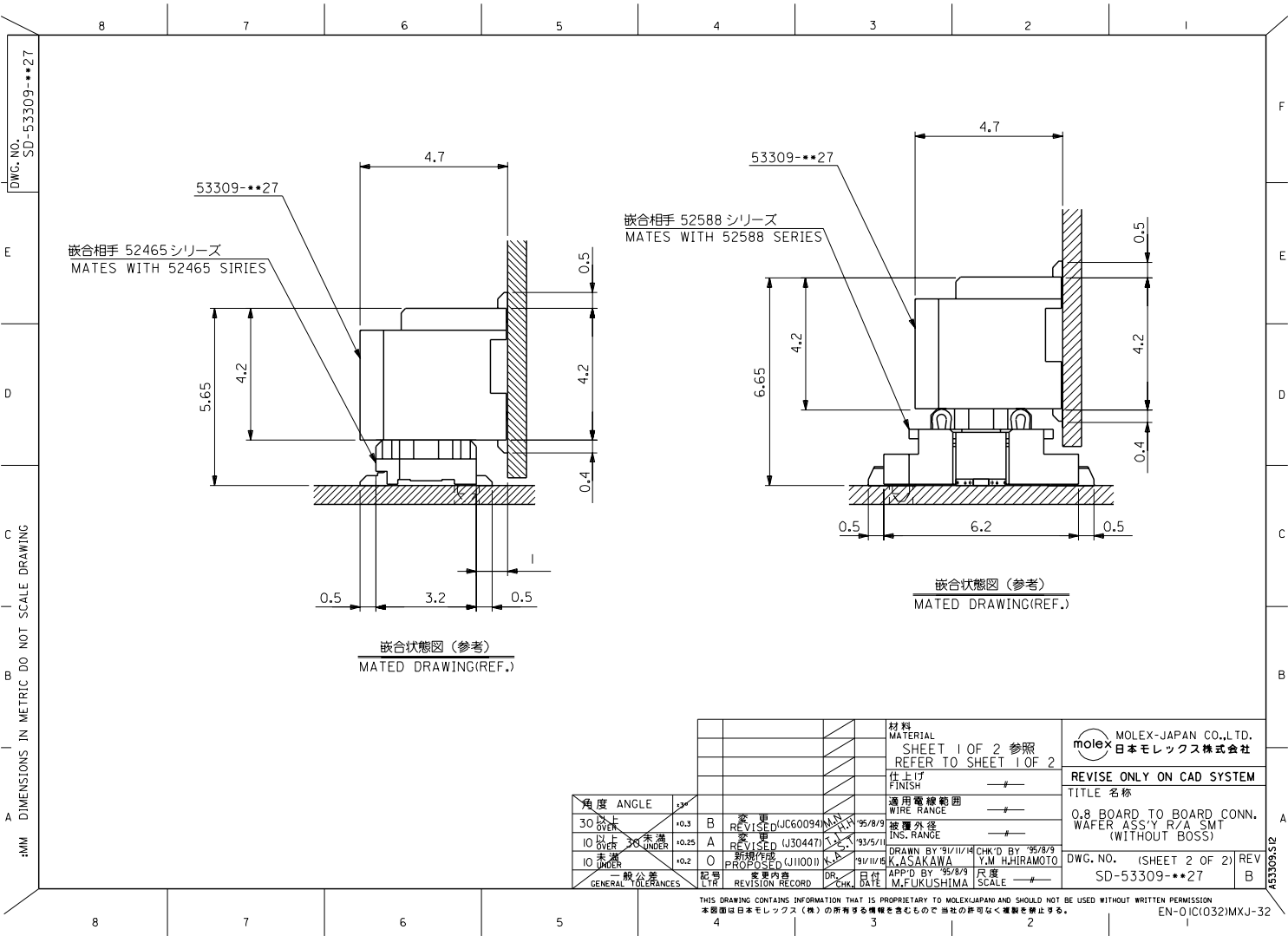
注記 NOTES
 1. 嵌合相手: 52465,52588 シリーズ
 MATE WITH: 52465,52588 SERIES
 △ ウェハーの ϕ から隣接するピンの ϕ 迄の位置を示す。
 SHOW POSITION FROM ϕ OF WAFER TO ϕ OF ADJACENT PINS.

0.4	17.8	16.9	15.2	53309-4027	40
0.8	17.0	16.1	14.4	-3827	38
0.4	16.2	15.3	13.6	-3627	36
0.8	15.4	14.5	12.8	-3427	34
0.4	14.6	13.7	12.0	-3227	32
0.8	13.8	12.9	11.2	-3027	30
0.4	13.0	12.1	10.4	-2827	28
0.8	12.2	11.3	9.6	-2627	26
0.4	11.4	10.5	8.8	-2427	24
0.8	10.6	9.7	8.0	-2227	22
0.4	9.8	8.9	7.2	-2027	20
0.8	9.0	8.1	6.4	-1827	18
0.4	8.2	7.3	5.6	-1627	16
0.8	7.4	6.5	4.8	-1427	14
0.4	6.6	5.7	4.0	-1227	12
0.8	5.8	4.9	3.2	53309-1027	10
D	C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3 B 変更 REVISD (JC60094) 95/8/9
10 以上 30 UNDER	±0.25 A REVISD (J30447) 93/5/11
10 UNDER	±0.2 O 新規作成 PROPOSED (J11001) 91/11/5
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD DR. CHK. DATE

材料 MATERIAL	図中参照 SEE DRAWING
仕上げ FINISH	---
適用電線範囲 WIRE RANGE	---
被覆外径 INS. RANGE	---
DRAWN BY	91/11/14 K.A.SAKAWA
CHK'D BY	95/8/9 Y.M.HIRAMOTO
APPR'D BY	95/8/9 M.FUKUSHIMA
尺度 SCALE	---
材料 MOLEX	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
REVISION RECORD	REVISION RECORD
TITLE 名称	0.8 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y R/A SMT (WITHOUT BOSS)
DWG. NO.	(SHEET 1 OF 2) SD-53309-**-27
REV	B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32

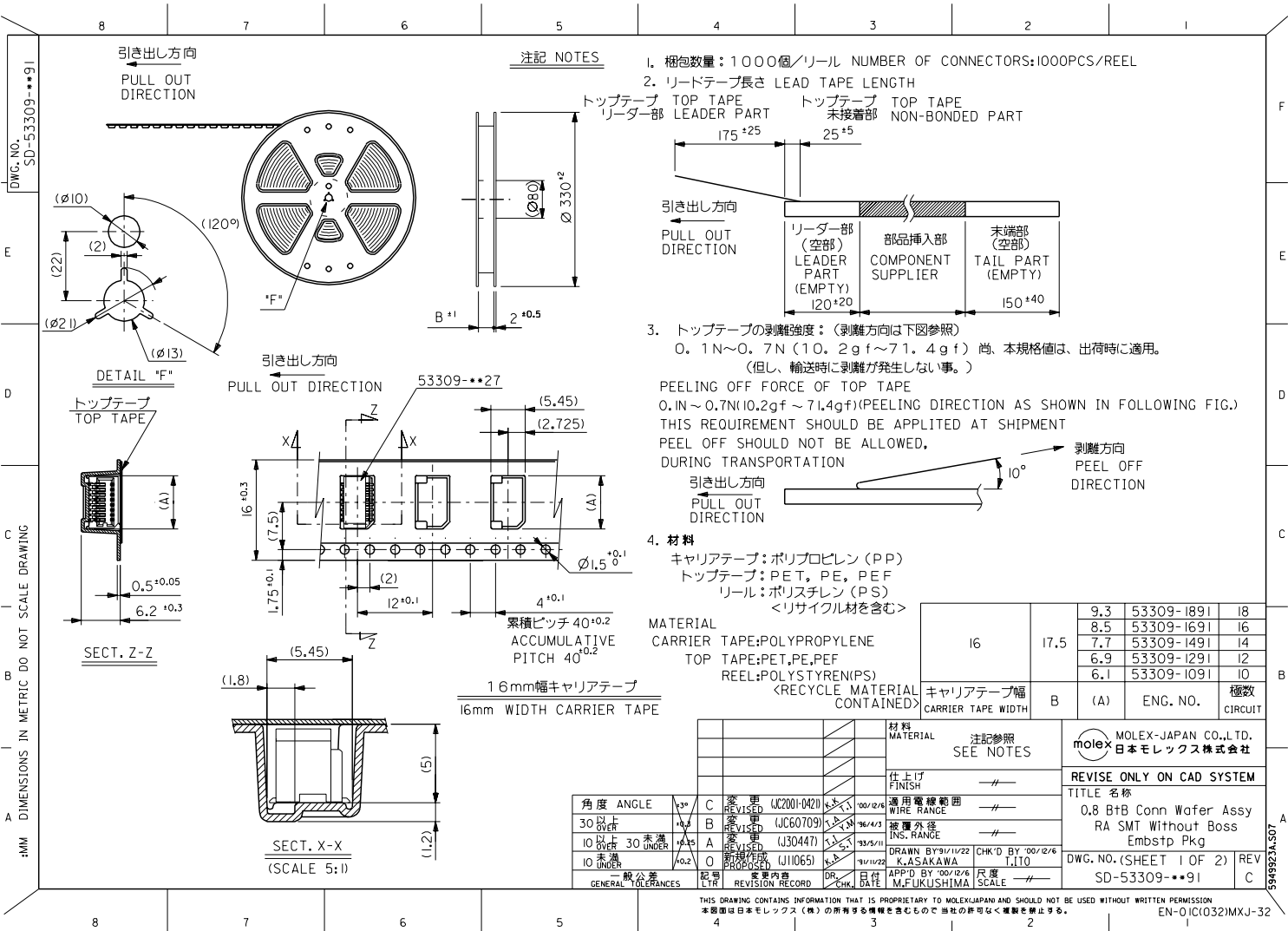


DWG. NO. SD-53309-**-27

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

角度 ANGLE		30°		材料 MATERIAL		SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
30°以上 OVER		+0.3		B 変更 REVISID(JC60094)		95/8/9		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
10°以上 30° UNDER		+0.25		A 新製 (J30447)		93/5/1		TITLE 名称	
10°未満 UNDER		+0.2		O 新製 (J11001)		91/11/8		0.8 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y R/A SMT (WITHOUT BOSS)	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		DR. 日付 DATE		DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV	
								SD-53309-**-27 B	

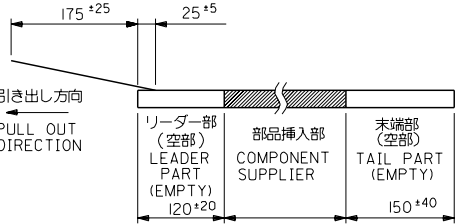
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する権利を有するもので 当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32



注記 NOTES

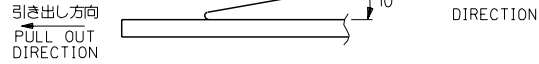
1. 梱包数量：1000個/リール NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

トップテープ TOP TAPE トップテープ TOP TAPE
 リーダー部 LEADER PART 未接着部 NON-BONDED PART



3. トップテープの剥離強度：(剥離方向は下図参照)
 0.1N~0.7N (10.2gf~71.4gf) (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
 (但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
 THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
 PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED.
 DURING TRANSPORTATION



4. 材料
 キャリアテープ：ポリプロピレン (PP)
 トップテープ：PET, PE, PEF
 リール：ポリスチレン (PS)
 <リサイクル材を含む>

MATERIAL
 CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
 TOP TAPE:PET,PE,PEF
 REEL:POLYSTYRENE(PS)
 <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

16	17.5	9.3	53309-1891	18	
		8.5	53309-1691	16	
		7.7	53309-1491	14	
		6.9	53309-1291	12	
		6.1	53309-1091	10	
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		B	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

角度 ANGLE	30°	C	変更 REVISED	(JC2001-0421)	9/1/22	適用電線範囲 WIRE RANGE	---
30以上 OVER	45°	B	変更 REVISED	(JC60709)	9/1/22	適用電線 INS. RANGE	---
10以上 30未満 OVER UNDER	45°	A	変更 REVISED	(J30447)	9/1/22	DRAWN BY	CHK'D BY
10未満 UNDER	40°	O	新規作成 PROPOSED	(J11065)	9/1/22	K.ASAKAWA	I.IIO
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	APP'D BY	尺度 SCALE

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	---	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
タイトル TITLE	0.8 BtB Conn Wafer Assy RA SMT Without Boss Embstop Pkg	
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2)	REV	SD-53309-**91

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する権利を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
 EN-01C(032)MXJ-32

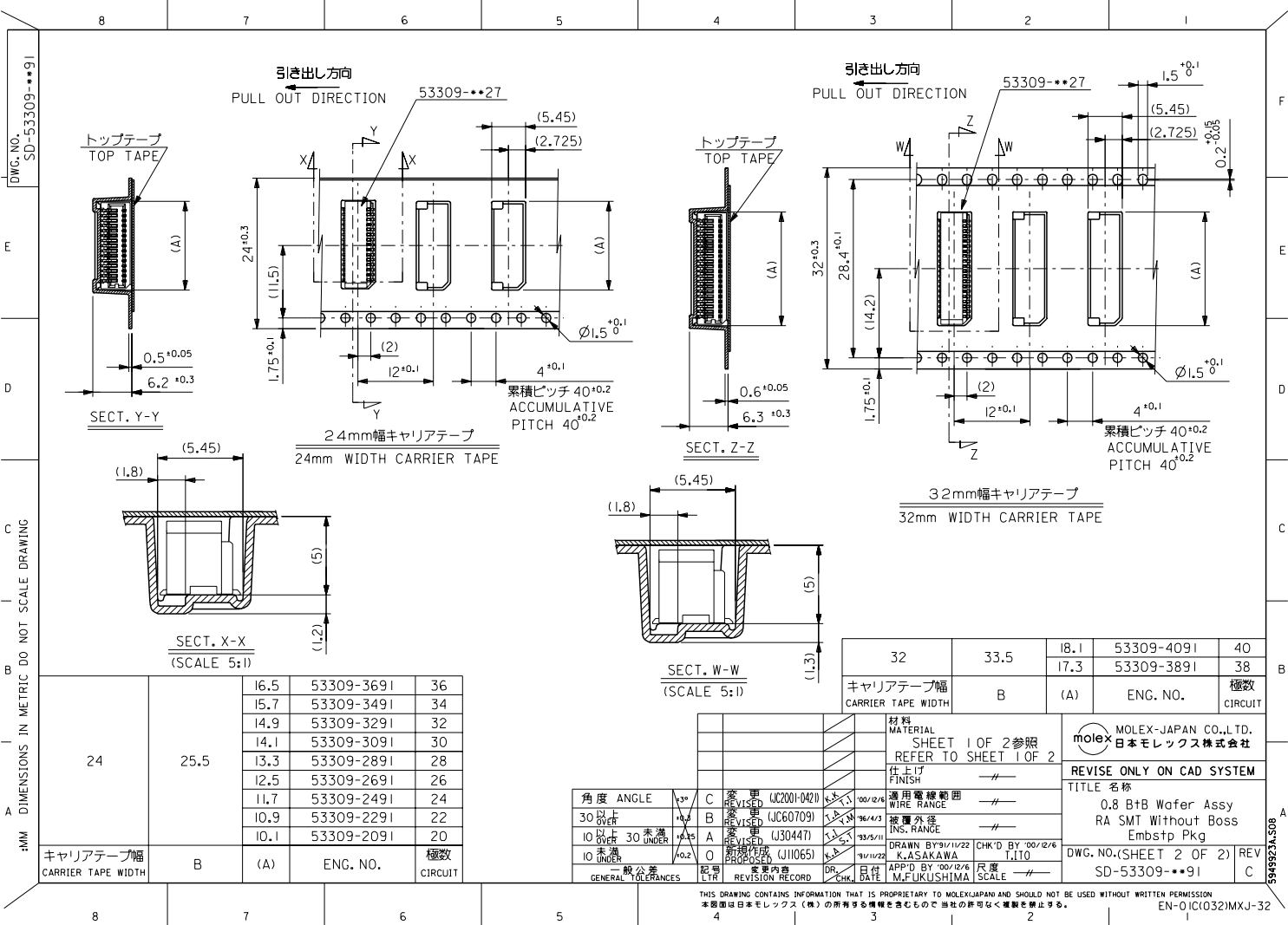
DWG. NO. SD-53309-**91

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

F
E
D
C
B
A

594923A.S07

8 7 6 5 4 3 2 1



DWG. NO. SD-53309-**91
 DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

24	25.5	16.5	53309-3691	36
		15.7	53309-3491	34
		14.9	53309-3291	32
		14.1	53309-3091	30
		13.3	53309-2891	28
		12.5	53309-2691	26
		11.7	53309-2491	24
		10.9	53309-2291	22
10.1	53309-2091	20		
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	B	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

角度 ANGLE	±30	C	変更 REVISED (JC2001-042)	00/12/6
30 以上 OVER	±45	B	変更 REVISED (JC60709)	98/11/2
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±45	A	変更 REVISED (J30447)	93/5/11
10 未満 UNDER	±0.2	O	新規作成 PROPOSED (J11065)	91/11/22
公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. 日付 CHK. DATE

32	33.5	18.1	53309-4091	40
17.3	53309-3891	38		
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	B	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

MATERIAL SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2
 仕上げ FINISH ---
 適用電線範囲 WIRE RANGE ---
 検査外径 INS. RANGE ---
 DRAWN BY 91/11/22 K.ASAKAWA
 APP'D BY 00/12/6 M.FUKUSHIMA
 尺度 SCALE ---

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社
 REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
 TITLE 名称
 0.8 BtB Wafer Assy
 RA SMT Without Boss
 Embstp Pkg
 DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV
 SD-53309-**91 C

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する権利を有するもので 当社の許可なく複製を禁止する。 EN-0(C)032)MXJ-32

5949323A.S08